Incidencias (y solución en el caso de ser necesario) en la construcción del componente HW del SE.

Incidencia HW1: broca mal posicionada, causaba vibraciones.

* Solución: reposicionar y reajustar, comprobar que el primer agujero no se haya dañado (se comprobó y no estaba suficientemente dañado como para requerir medidas adicionales).

Incidencia HW2: condensadores de tamaño entre pines (pitch) de casi 5mm en vez de 2.5mm.

* Solución: usar un objeto para doblar los pines hacia adentro a la posición adecuada.